2024-2029年半导体硅片、外延片行业市场前景预测与投资战略规划分析报告

目 录

CONTENTS

——综述篇——
第1章：半导体硅片（硅晶圆）行业综述及数据来源说明
1.1 半导体硅片行业界定
1.1.1 半导体硅片的定义
1.1.2 半导体硅片的性质
1、半导体硅片具有显著的半导特性
2、半导体硅片的p-n结构性与光电特性
1.1.3 硅片是需求量最大的半导体晶圆制造材料
1.1.4 半导体硅片所处行业
1.1.5 半导体硅片术语与辨析
1、半导体硅片专业术语
2、半导体硅片概念辨析
1.2 半导体硅片行业分类
1.2.1 按尺寸划分
1.2.2 按掺杂程度划分：轻掺和重掺
1.2.3 按工艺划分：研磨片、抛光片、外延片、SOI等
1.2.4 按应用场景划分：正片、假（陪）片、刻蚀电极
1.3 本报告研究范围界定说明
1.4 半导体硅片行业市场监管&标准体系
1.4.1 半导体硅片行业监管体系及机构职能
1.4.2 半导体硅片行业标准体系及建设进程
1.5 本报告数据来源及统计标准说明
1.5.1 本报告权威数据来源
1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明
——半导体硅片（硅晶圆）——
第2章：全球半导体硅片（硅晶圆）行业发展现状及趋势洞察
2.1 全球半导体硅片行业发展历程
2.2 全球半导体硅片行业市场发展现状
2.2.1全球半导体硅片企业扩产计划
2.2.2 全球半导体硅片出货面积
2.2.3 全球半导体硅片单价变化
2.2.4 全球不同尺寸半导体硅片出货面积
2.2.5 全球半导体硅片大尺寸发展
2.2.6 芯片制程不断缩小
2.2.6 全球半导体硅片下游应用市场概况
2.3 全球半导体硅片行业竞争状况
2.3.1 全球半导体硅片行业兼并重组状况
2.3.2 全球半导体硅片行业市场竞争格局
2.3.3 全球半导体硅片行业集中度
2.4 全球半导体硅片行业区域发展&贸易流向
2.4.1 全球半导体硅片区域发展格局
2.4.2 全球半导体硅片重点区域市场——日本
1、日本硅晶圆发展概况分析
2、日本半导体硅片企业竞争分析
3、日本半导体硅片行业发展趋势
2.4.3 全球半导体硅片贸易流向
2.4.4 全球半导体硅片产业转移
2.5 全球半导体硅片行业市场规模体量及前景预判
2.5.1 全球半导体硅片行业市场规模体量

2.5.2 全球半导体硅片行业市场前景预测（未来5年预测）
1、全球硅晶圆出货预测
2、全球硅晶圆规模预测
2.5.3 全球半导体硅片行业发展趋势洞悉
1、应用趋势分析
2、产品趋势分析
3、技术趋势分析
4、市场趋势分析
2.6 全球半导体硅片行业发展经验总结和有益借鉴
第3章：中国半导体硅片（硅晶圆）行业发展现状及市场痛点
3.1 中国半导体硅片行业发展历程
3.2 中国半导体硅片行业技术进展
3.2.1 半导体硅片行业科研投入（力度及强度）
3.2.2 半导体硅片行业科研创新（专利与转化）
3.2.3 半导体硅片制作流程
1、拉单晶（直拉法）
2、拉单晶（区熔法）
3、晶棒切片
4、硅片倒角
5、硅片研磨
6、蚀刻和抛光
7、清洁和检查
3.2.4 半导体硅片核心工艺
1、单晶工艺
2、切片工艺
3、研磨工艺
4、抛光工艺
5、外延工艺
3.3 中国半导体硅片行业对外贸易状况
3.3.1 海关总署——半导体硅片统计归类——3818.0011&3818.0019&3818.0090
3.3.2 中国半导体硅片行业进出口贸易概况（过去5年数据）
3.3.3 中国半导体硅片行业进口贸易状况（过去5年数据）
1、半导体硅片行业进口贸易规模
2、半导体硅片行业进口价格水平
3、半导体硅片行业进口产品结构
3.3.4 中国半导体硅片行业出口贸易状况（过去5年数据）
1、半导体硅片行业出口贸易规模
2、半导体硅片行业出口价格水平
3、半导体硅片行业出口产品结构
3.3.5 中国半导体硅片行业进出口贸易影响因素及发展趋势
3.4 中国半导体硅片行业市场主体
3.4.1 半导体硅片行业市场主体类型
3.4.2 半导体硅片行业企业入场方式
3.5 中国半导体硅片产能统计
3.5.1 8英寸半导体硅片产能统计（现有及规划）
3.5.2 12英寸半导体硅片产能统计（现有及规划）
3.6 晶圆制造企业对半导体硅片厂商的认证过程
3.7 晶圆厂数量及投建扩产计划
3.7.1 新增晶圆厂数量
3.7.2 晶圆厂投建扩产计划
3.8 中国半导体硅片行业市场规模体量
3.9 中国半导体硅片行业市场发展痛点
第4章：中国半导体硅片（硅晶圆）行业市场竞争及投资并购
4.1 中国半导体硅片行业市场竞争布局状况
4.1.1 中国半导体硅片行业竞争者入场进程
4.1.2 中国半导体硅片行业竞争者省市分布热力图
4.1.3 中国半导体硅片行业竞争者战略布局状况
4.2 中国半导体硅片行业市场竞争格局分析
4.2.1 中国半导体硅片行业企业竞争集群分布

4.2.2 中国半导体硅片行业企业竞争格局分析
4.2.3 中国半导体硅片行业市场集中度分析
4.3 中国半导体硅片国产化率及企业国产替代布局现状
4.4 中国半导体硅片行业波特五力模型分析
4.4.1 中国半导体硅片行业供应商的议价能力
4.4.2 中国半导体硅片行业消费者的议价能力
4.4.3 中国半导体硅片行业新进入者威胁
4.4.4 中国半导体硅片行业替代品威胁
4.4.5 中国半导体硅片行业现有企业竞争
4.4.6 中国半导体硅片行业竞争状态总结
4.5 中国半导体硅片行业投融资&并购重组&上市情况
4.5.1 中国半导体硅片行业投融资状况
1、中国半导体硅片行业投融资概述（资金来源及投融资主体）
2、中国半导体硅片行业投融资汇总
3、中国半导体硅片行业投融资规模
4、中国半导体硅片行业投融资解读（热门领域/融资轮次/对外投资等）
4、中国半导体硅片行业投融资趋势
4.5.2 中国半导体硅片行业兼并与重组
1、中国半导体硅片行业兼并与重组汇总
2、中国半导体硅片行业兼并与重组方式
3、中国半导体硅片行业兼并与重组案例
4、中国半导体硅片行业兼并与重组趋势
4.5.3 中国半导体硅片行业IPO动态（已上市、申请&被否情况）
第5章：半导体硅片（硅晶圆）产业链全景及配套产业发展
5.1 半导体硅片产业链结构梳理
5.2 半导体硅片产业链生态图谱
5.3 半导体硅片产业链区域热力图
5.4 半导体硅片行业成本结构
5.5 半导体硅片原材料市场分析
5.5.1 半导体硅片原材料概述
5.5.2 硅料
1、硅料产能
2、硅料产量
3、硅料价格
5.5.3 电子级多晶硅
1、电子级多晶硅产能
2、电子级多晶硅产量
3、电子级多晶硅价格
5.5.4 半导体级单晶硅
1、半导体级单晶硅产能
2、半导体级单晶硅产量
3、半导体级单晶硅价格
5.5.5 半导体硅片原材料发展趋势
5.6 半导体硅片生产设备/生产线市场分析
5.6.1 半导体硅片国产化现状及市场概况
5.6.2 拉晶设备市场概况及厂商
5.6.3 切片设备市场概况及厂商
5.6.4 抛光设备市场概况及厂商
5.6.5 清洗设备市场概况及厂商
5.6.6 检测设备市场概况及厂商
5.6.7 半导体硅片自动化生产解决方案
5.7 配套产业布局对半导体硅片行业的影响总结
第6章：中国半导体硅片（硅晶圆）行业细分产品市场分析
6.1 中国半导体硅片行业细分市场概况
6.1.1 半导体硅片尺寸发展历程
6.1.2 硅片向大尺寸迁移是大势所趋
6.1.3 半导体硅片细分市场结构
6.2 半导体硅片细分市场：8寸（200mm）及以下半导体硅片
6.2.1 8寸（200mm）及以下半导体硅片概述

6.2.2 8寸（200mm）及以下硅晶圆厂数量分析
6.2.3 8寸（200mm）及以下硅晶圆产能统计
6.2.4 8寸（200mm）及以下硅晶圆出货情况
6.2.5 8寸（200mm）及以下硅晶圆市场规模
6.2.6 8寸（200mm）及以下硅晶圆竞争情况
6.2.7 8寸（200mm）及以下硅晶圆前景分析
6.3 半导体硅片细分市场：12寸（300mm）半导体硅片
6.3.1 12寸（300mm）硅晶圆概述
6.3.2 12寸（300mm）晶圆厂数量分析
6.3.3 12寸（300mm）硅晶圆产能统计
6.3.4 12寸（300mm）硅晶圆出货情况
6.3.5 12寸（300mm）硅晶圆市场规模
6.3.6 12寸（300mm）硅晶圆竞争情况
6.3.7 12寸（300mm）硅晶圆前景分析
6.4 半导体硅片细分市场：18寸（450mm）半导体硅片
6.5 中国半导体硅片行业细分市场战略地位分析
第7章：中国半导体硅片（硅晶圆）行业细分应用市场分析
7.1 半导体硅片应用场景&市场领域分布
7.1.1 不同尺寸硅片下游应用有所不同
7.1.2 8寸半导体硅片下游应用领域分布
7.1.3 12寸半导体硅片下游应用领域分布
7.2 半导体硅片细分应用：集成电路（IC）
7.2.2 集成电路（IC）发展状况
1、集成电路（IC）发展现状
2、逻辑芯片（逻辑IC）发展现状
3、模拟芯片（模拟IC）发展现状
4、集成电路（IC）发展趋势
7.2.1 集成电路（IC）领域半导体硅片应用概述
7.2.3 集成电路（IC）领域半导体硅片市场现状
7.2.4 集成电路（IC）领域半导体硅片需求潜力
7.3 半导体硅片细分应用：分立器件
7.3.1 分立器件发展状况
1、分立器件发展现状
2、分立器件发展趋势
7.3.2 分立器件领域半导体硅片应用概述
7.3.3 分立器件领域半导体硅片市场现状
7.3.4 分立器件领域半导体硅片需求潜力
7.4 半导体硅片细分应用：传感器
7.4.1 传感器发展状况
1、传感器发展现状
2、传感器发展趋势
7.4.2 传感器领域半导体硅片应用概述
7.4.3 传感器领域半导体硅片市场现状
7.4.4 传感器领域半导体硅片需求潜力
7.5 半导体硅片细分应用：光电器件
7.5.1 光电器件发展状况
1、光电器件发展现状
2、光电器件发展趋势
7.5.2 光电器件领域半导体硅片应用概述
7.5.3 光电器件领域半导体硅片市场现状
7.5.4 光电器件领域半导体硅片需求潜力
7.6 中国半导体硅片行业细分应用市场战略地位分析
第8章：中国半导体硅片（硅晶圆）行业发展环境洞察&SWOT分析
8.1 中国半导体硅片行业经济（Economy）环境分析
8.1.1 中国宏观经济发展现状
8.1.2 中国宏观经济发展展望
8.1.3 中国半导体硅片行业发展与宏观经济相关性分析
8.2 中国半导体硅片行业社会（Society）环境分析
8.2.1 中国半导体硅片行业社会环境分析

8.2.2 社会环境对半导体硅片行业发展的影响总结
8.3 中国半导体硅片行业政策（Policy）环境分析
8.3.1 国家层面半导体硅片行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）
1、国家层面半导体硅片行业政策汇总及解读
2、国家层面半导体硅片行业规划汇总及解读
8.3.2 31省市半导体硅片行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）
1、31省市半导体硅片行业政策规划汇总
2、31省市半导体硅片行业发展目标解读
8.3.3 国家重点规划/政策对半导体硅片行业发展的影响
8.3.4 政策环境对半导体硅片行业发展的影响总结
8.4 中国半导体硅片行业SWOT分析（优势/劣势/机会/威胁）
第9章：中国半导体硅片（硅晶圆）行业市场前景及发展趋势分析
9.1 中国半导体硅片行业发展潜力评估
9.2 中国半导体硅片行业未来关键增长点分析
9.3 中国半导体硅片行业发展前景预测（未来5年预测）
9.4 中国半导体硅片行业发展趋势预判
9.4.1 应用趋势分析
9.4.2 产品趋势分析
9.4.3 技术趋势分析
9.4.4 竞争趋势分析
9.4.5 市场趋势分析
第10章：中国半导体硅片（硅晶圆）行业投资战略规划策略及建议
10.1 中国半导体硅片行业进入与退出壁垒
10.1.1 半导体硅片行业进入壁垒分析
1、技术壁垒
2、客户认证壁垒
3、资金壁垒
4、规模壁垒
5、人才壁垒
10.1.2 半导体硅片行业退出壁垒分析
10.2 中国半导体硅片行业投资风险预警
10.2.1 供求失衡风险
10.2.2 原材料价格波动风险
10.2.3 政策风险
10.3 中国半导体硅片行业投资机会分析
10.3.1 半导体硅片产业链薄弱环节投资机会
10.3.2 半导体硅片行业细分领域投资机会
10.3.3 半导体硅片行业区域市场投资机会
10.3.4 半导体硅片产业空白点投资机会
10.4 中国半导体硅片行业投资价值评估
10.5 中国半导体硅片行业投资策略与建议
——外延片——
第11章：外延片行业发展综述
11.1 LED产业链结构及价值环节
11.1.1 LED产业链结构简介
11.1.2 LED产业链价值环节
11.1.3 LED产业链投资情况
1、产业链上游投资情况
2、产业链中游投资情况
3、产业链下游投资情况
11.1.4 LED产业链竞争格局
1、产业链上游被日、欧、美企业垄断
2、产业链中游台韩企业占优
3、产业链下游本土企业与国际品牌共存
11.2 LED外延发光材料的选择
11.2.1 LED发光技术的基础
1、半导体自发发射跃迁
2、半导体自发发射跃迁特点
11.2.2 半导体能带特征和外延材料选择

1、可见光波长与外延半导体禁带宽度的关系
2、直接跃迁与间接跃迁
3、外延材料选择
11.3 LED芯片行业发展现状分析
11.3.1 全球LED芯片行业市场分析
1、全球LED芯片市场规模
2、全球LED芯片竞争格局
3、全球LED芯片区域分布
4、全球LED芯片前景分析
11.3.2 中国LED芯片行业市场分析
1、中国LED芯片市场规模
2、中国LED芯片竞争格局
3、中国LED芯片区域分布
4、中国LED芯片前景分析
第12章：国内外外延片行业发展状况分析
12.1 全球外延片行业发展现状分析
12.1.1 全球外延片行业发展概况
12.1.2 全球外延片市场发展现状分析
12.1.3 全球外延片竞争格局分析
12.1.4 全球外延片市场前景分析
12.2 中国外延片行业发展现状分析
12.2.1 中国外延片行业发展概况
12.2.2 中国外延片行业供给情况
12.2.3 中国外延片行业需求情况
12.3 中国外延片行业竞争格局分析
12.3.1 中国外延片行业竞争格局
12.3.2 中国外延片行业五力分析
1、行业现有竞争者分析
2、行业潜在进入者威胁
3、行业替代品威胁分析
4、行业供应商议价能力分析
5、行业购买者议价能力分析
6、行业竞争情况总结
第13章：外延片行业前景预测与投资建议
13.1 外延片行业发展趋势与前景预测
13.1.1 行业发展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
13.1.2 行业发展趋势预测
13.1.3 行业发展前景预测
13.2 外延片行业投资现状与风险分析
13.2.1 行业投资现状分析
13.2.2 行业进入壁垒分析
1、技术与人才壁垒
2、资金壁垒
13.2.3 行业经营模式分析
13.2.4 行业投资风险预警
1、下游市场季节性波动风险
2、宏观经济波动风险
3、市场竞争风险
13.3 外延片行业投资机会与热点分析
13.3.1 行业投资价值分析
13.3.2 行业投资机会分析
13.3.3 行业投资热点分析
13.3.4 行业投资策略分析
——领先企业——
第14章：中国半导体硅片企业案例解析
14.1 中国半导体硅片企业梳理与对比
14.1.1 业务布局对比

14.1.2 研发投入对比
14.1.3 营收规模对比
14.1.4 盈利能力对比
14.2 中国半导体硅片企业案例分析（不分先后，可定制）
14.2.1 台湾环球晶圆 Global Wafers
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.2 上海硅产业集团股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.3 TCL中环新能源科技股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.4 杭州立昂微电子股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.5 锦州神工半导体股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.6 浙江中晶科技股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.7 有研半导体硅材料股份公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户

7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.8 上海超硅半导体股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.9 西安奕斯伟硅片技术有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
14.2.10 麦斯克电子材料股份有限公司
1、企业基本信息
2、企业经营情况
3、企业业务架构/营收结构
4、企业半导体硅片产线布局
5、企业半导体硅片尺寸布局
6、企业半导体硅片合作客户
7、企业半导体硅片布局战略&优劣势
第15章：中国外延片企业案例分析
15.1 中国外延片企业梳理与对比
15.2 中国外延片领先企业案例分析（不分先后，可定制）
15.2.1 三安光电股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
（1）企业主要经济指标
（2）企业盈利能力分析
（3）企业运营能力分析
（4）企业偿债能力分析
（5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业外延片业务经营情况
7、企业渠道分布分析
8、企业发展优劣势分析
9、企业最新发展动向分析
15.2.2 杭州士兰微电子股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
（1）企业主要经济指标
（2）企业盈利能力分析
（3）企业运营能力分析
（4）企业偿债能力分析
（5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业典型客户分析
7、企业发展优劣势分析
8、企业最新发展动向分析
15.2.3 厦门乾照光电股份有限公司
1、企业发展简况分析

2、企业主要经济指标
（1）企业主要指标分析
（2）企业盈利能力分析
（3）企业运营能力分析
（4）企业偿债能力分析
（5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业外延片业务经营情况
7、企业销售区域分析
8、企业发展优劣势分析
9、企业最新发展动向分析
15.2.4 安徽德豪润达电气股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
（1）企业主要经济指标
（2）企业盈利能力分析
（3）企业运营能力分析
（4）企业偿债能力分析
（5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
5、企业典型客户分析
6、企业发展优劣势分析
7、企业最新发展动向分析
15.2.5 有研新材料股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
（1）企业主要经济指标
（2）企业盈利能力分析
（3）企业运营能力分析
（4）企业偿债能力分析
（5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
（1）研发团队
（2）研发专利布局
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业外延片业务经营情况
7、企业销售网络分析
8、企业发展优劣势分析
15.2.6 华灿光电股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
（1）企业主要指标分析
（2）企业盈利能力分析
（3）企业运营能力分析
（4）企业偿债能力分析
（5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
（1）研发团队
（2）技术研发方向布局
（3）技术专利布局
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业外延片业务经营情况
7、企业发展优劣势分析
8、企业最新发展动向分析

15.2.7 无锡华润华晶微电子有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业经营情况分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业外延片业务经营情况
7、企业典型客户分析
8、企业发展优劣势分析
15.2.8 江苏澳洋顺昌股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
（1）企业主要指标分析
（2）企业盈利能力分析
（3）企业运营能力分析
（4）企业偿债能力分析
（5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业外延片业务经营情况
7、企业销售区域分布情况
8、企业发展优劣势分析
9、企业最新发展动向分析
15.2.9 上海新傲科技股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业经营情况分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
（1）研发部门布局
（2）研发团队
5、企业外延片产能及在建项目
6、企业外延片业务经营情况
7、企业典型客户分析
8、企业发展优劣势分析
15.2.10 江西联创光电科技股份有限公司
1、企业发展简况分析
2、企业主要经济指标
（1）企业主要经济指标
（2）企业盈利能力分析
（3）企业运营能力分析
（4）企业偿债能力分析
（5）企业发展能力分析
3、企业产品结构分析
4、企业外延片技术水平分析
5、企业外延片业务经营情况
6、企业发展优劣势分析
7、企业最新发展动向分析

图表目录

图表1：半导体硅片的定义
图表2：半导体硅片图示
图表3：单晶硅的电阻率特性（单位：k）
图表4：半导体硅片的P-N型结构
图表5：半导体硅片的光电特性

图表6：本报告研究领域所处行业
图表7：半导体硅片专业术语
图表8：半导体硅片概念辨析
图表9：半导体硅片分类情况（单位：毫米，微米，平方厘米，克，英寸）
图表10：本报告研究范围界定
图表11：中国半导体硅片行业监管体系结构图
图表12：中国半导体硅片行业主管部门&行业协会&自律组织机构职能
图表13：半导体硅片行业标准体系框架&建设进程（国家/地方/行业/团体/企业标准）
图表14：中国半导体硅片行业现行&即将实施标准汇总
图表15：中国半导体硅片行业重点标准及其影响解读
图表16：本报告权威数据资料来源汇总
图表17：本报告的主要研究方法及统计标准说明
图表18：全球半导体硅片行业发展历程
图表19：半导体硅片平均价格走势（单位：美元/平方英寸）
图表20：全球不同尺寸半导体硅片产品结构（单位：%）
图表21：全球不同尺寸半导体硅片产品结构示意图
图表22：全球半导体硅片行业兼并重组状况
图表23：全球半导体硅片行业市场竞争格局
图表24：全球半导体硅片行业市场发展现状
图表25：全球硅晶圆市场份额分布情况（单位：%）
图表26：全球半导体硅片区域发展格局
图表27：全球半导体硅片（产能）区域分布（单位：%）
图表28：全球半导体硅片行业重点区域市场分析
图表29：日本硅锗晶圆出口国家分布结构（单位：吨）
图表30：日本半导体硅片主要供应商
图表31：全球半导体硅片行业市场规模体量分析
图表32：全球半导体硅片营收规模及增长情况（单位：亿美元，%）
图表33：全球半导体硅片行业市场前景预测（未来5年预测）
图表34：2023-2028年全球硅晶圆出货量预测（单位：百万平方英寸）
图表35：2023-2028年全球硅晶圆市场规模预测（单位：亿美元）
图表36：全球半导体硅片行业发展趋势洞悉
图表37：全球半导体硅片应用趋势分析
图表38：全球半导体硅片产品趋势分析
图表39：全球半导体硅片技术趋势分析
图表40：全球半导体硅片市场趋势分析
图表41：全球半导体硅片行业发展经验总结和有益借鉴
图表42：中国半导体硅片行业发展历程
图表43：半导体硅片行业科研投入状况（研发力度及强度）
图表44：半导体硅片行业科研投入（力度及强度）
图表45：半导体硅片行业科研创新（专利与转化）
图表46：半导体硅片行业关键技术（现状与发展）
图表47：半导体硅片行业市场主体类型（投资/经营/服务/中介主体）
图表48：半导体硅片行业企业入场方式（自建/并购/战略合作等）
图表49：半导体硅片行业市场主体数量
图表50：半导体硅片注册/在业/存续企业
图表51：中国半导体硅片行业市场供给分析
图表52：中国半导体硅片行业市场规模体量分析
图表53：中国半导体硅片市场规模（单位：亿美元）
图表54：中国半导体硅片行业市场发展痛点分析
图表55：中国半导体硅片行业竞争者入场进程
图表56：中国半导体硅片行业竞争者区域分布热力图
图表57：中国半导体硅片行业竞争者发展战略布局状况
图表58：中国半导体硅片行业企业战略集群状况
图表59：中国半导体硅片行业企业竞争格局分析
图表60：中国半导体硅片行业市场集中度分析
图表61：中国半导体硅片国产化率及企业国产替代布局现状
图表62：中国半导体硅片行业供应商的议价能力
图表63：中国半导体硅片行业消费者的议价能力
图表64：中国半导体硅片行业新进入者威胁

图表65：中国半导体硅片行业替代品威胁
图表66：中国半导体硅片行业现有企业竞争
图表67：中国半导体硅片行业竞争状态总结
图表68：中国半导体硅片行业资金来源
图表69：中国半导体硅片行业投融资主体
图表70：中国半导体硅片行业投融资汇总
图表71：中国半导体硅片行业投融资规模
图表72：中国半导体硅片行业投融资解读
图表73：中国半导体硅片行业兼并与重组汇总
图表74：中国半导体硅片行业兼并与重组方式
图表75：中国半导体硅片行业兼并与重组案例
图表76：中国半导体硅片行业兼并与重组趋势
图表77：半导体硅片产业链结构梳理
图表78：半导体硅片产业链生态图谱
图表79：半导体硅片产业链区域热力图
图表80：半导体硅片行业成本结构
图表81：半导体硅片行业价值链分析图
图表82：半导体硅片原材料市场发展现状
图表83：半导体硅片尺寸发展历程（单位：英寸，mm）
图表84：中国半导体硅片行业细分市场结构
图表85：8寸（200mm）及以下硅晶圆应用领域及范围
图表86：全球运营的8寸（200mm）晶圆厂数量及预测（单位：座）
图表87：2013-2022年全球8寸晶圆厂产量变化情况分析（单位：万片，%）
图表88：8英寸及以下晶圆制造厂装机产能情况（单位：万片）
图表89：中国8/12英寸半导体硅片产能布局图
图表90：全球8寸（200mm）及以下硅晶圆出货情况（单位：百万平方英寸）
图表91：全球8寸（200mm）及以下硅晶圆市场规模（单位：亿美元）
图表92：全球及中国主要8寸（200mm）及以下硅晶圆厂及分布
图表93：2023-2028年全球8寸（200mm）及以下硅晶圆出货预测（单位：百万平方英寸）
图表94：12寸（300mm）硅晶圆应用领域情况
图表95：全球12寸晶圆厂数量情况及预测（单位：座）
图表96：中国12英寸晶圆制造厂装机产能（单位：万片，%）
图表97：中国12寸晶圆厂企业投产产能汇总（单位：千片/月）
图表98：全球12寸（300mm）硅晶圆出货情况（单位：百万平方英寸）
图表99：全球12寸（300mm）硅晶圆市场规模情况（单位：亿美元）
图表100：全球及中国运营的12寸（300mm）晶圆厂分布情况
图表101：2023-2028年全球12寸（300mm）硅晶圆出货预测（单位：百万平方英寸）
图表102：中国半导体硅片行业细分市场战略地位分析
图表103：不同尺寸半导体硅片应用场领域
图表104：中国半导体硅片细分应用市场结构
图表105：集成电路（IC）发展现状
图表106：集成电路（IC）发展趋势
图表107：集成电路（IC）领域半导体硅片应用概述
图表108：集成电路（IC）领域半导体硅片市场现状
图表109：集成电路（IC）领域半导体硅片需求潜力
图表110：分立器件发展现状
图表111：分立器件发展趋势
图表112：分立器件领域半导体硅片应用概述
图表113：分立器件领域半导体硅片市场现状
图表114：分立器件领域半导体硅片需求潜力
图表115：传感器发展现状
图表116：传感器发展趋势
图表117：传感器领域半导体硅片应用概述
图表118：传感器领域半导体硅片市场现状
图表119：传感器领域半导体硅片需求潜力
图表120：光电器件发展现状
略····完整目录请咨询客服

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！